

# 単槽式 窒素/真空リフロー装置

Ver.7

用途

Type NRY-703WSZ/VA "VA" は真空オプション装備の型式(写真)

1. パワーモジュール基板のボイドレスリフローに！
2. ウェハー・モジュール基板の電極半田バンプ形成に！



特許第5174272号

特許第5955232号

## 装置の特長

1. 単槽(1チャンバー)で、予熱→昇温→冷却ができます(特許5174272号)
2. 「浮遊ガス加熱」(特許第5955232号)により、反りや撓みの影響なく加熱ができます
3. 窒素注入(標準装備)することで、30ppm以下の低酸素濃度でリフロー半田付けやバンプ形成ができます
4. 半田熔融中に、チャンバー内を急速に減圧させることで、ボイド(空隙)除去が可能です(オプション)
5. 入口コンベアとの接続で、自動インライン化にも対応できます(標準装備)



株式会社 大和製作所

YAMATO WORKS CO., LTD.